113學年度課程規劃表　　電子工程系-封裝測試產業精英專班　　進修部二技

第一學年(113)						第二學年(114)					
	科目	上學期		下學期			科目	上學期		下學期	
		學分	時數	學分	時數			學分	時數	學分	時數
專業必修	※封裝能力鑑定(一)	3	3			專業必修	※測試能力鑑定(一)	3	3		
	※Tester設備操作與維修概論	3	3				※BIB治具設備操作與維修概論	3	3		
	※Handler設備操作與維修概論	3	3				※Laser Marker設備操作與維修概論	3	3		
	※HF設備操作與維修概論	3	3				※Lead Scanner原理與應用	3	3		
	※積體電路工程	3	3				※半導體製程實務	3	3		
	※半導體元件	3	3				※實務專題	3	3		
	※半導體製程技術			3	3		※半導體產業分析			3	3
	※積體電路可靠性工程			3	3		※捲帶機原理與應用			3	3
	※Oven設備操作與維修概論			3	3		※打線機原理與應用			3	3
	※LD/UL設備操作與維修概論			3	3		※黏晶機設備操作與維修概論			3	3
	※治具設備操作與維修概論			3	3		※測試能力鑑定(二)			3	3
	※封裝能力鑑定(二)			3	3		※實務專題			3	3
	小計	18	18	18	18		小計	18	18	18	18

【科目類別】

通識科目(分類通識)：校必修

專業科目：院必修、專業必修、專業選修

【科目類別】		學分	時數
通識科目	校必修		
專業科目	院必修		
	專業必修	72	72
	專業選修		
合計		72	72

【注意事項】

1. 最低畢業學分：72 學分，其中專業選修0學分(本系至少0學分，其餘可跨系)。
2. 表列專業選修課程，得依實際情況逕行調整。

113.05.20

明新科技大學電子系課程教學小組

明新學校財團法人明新科技大學 電子工程系 新竹縣新豐鄉新興路1號

電子工程系主任 張丞勛

半導體學院院長 張合